台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司
發佈日期：2026年11月10日

台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日召開董事會，會中重要決議如下：

一、 核准 2026 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣 1 兆 4,942 億 4 千萬元，稅後純益約新台幣 7,630 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 29.43 元。

二、 核准配發 2026 年第三季之每股現金股利 9.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2027 年 3 月 17 日，除息交易日則為 2027 年 3 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2027 年 3 月 13 日起至 3 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2027 年 4 月 8 日發放。台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2027 年 3 月 11 日。

三、 為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 409 億 2,670 萬元，內容主要包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程；4. 2027 年研發資本預算、經常性資本預算及資本化租賃資產預算。

四、 核准以不超過美金 5 億元之資金設立一投資公司，以進行半導體產業及相關生態系之策略性投資。

五、 核准於不超過美金 5 億元之額度內認購 Anthropic, PBC 普通股股份，每股認購價格將依該公司首次公開發行之價格而定；以及於不超過美金 5 億元之額度內認購 OpenAI Group PBC 特別股股份。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2025 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 305 種製程技術，為 534 個客戶生產 1 萬 2,682 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 https://www.tsmc.com.tw 查詢。

# # #

台積公司發言人：
黃仁昭
資深副總經理暨財務長

台積公司新聞連絡人：
高孟華
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: press@tsmc.com

李國維
企業公共關係處
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: press@tsmc.com